

Описуються попередньо сформовані композиції в профільованій формі, що містять полімерні суміші, і застосування даних попередньо сформованих композицій у профільованій формі для закладання апертур. У певних варіантах реалізації попередньо сформовані композиції є електропровідними та здатними екранувати випромінювання EMI/RFI. Полімерна суміш включає полісульфідний компонент і компонент на основі простого полігіоефіру.